

第 25 回エレクトロニクス実装学会春季講演大会プログラム

会期：平成 23 年 3 月 8 日(火)～10 日(木) 会場：横浜国立大学 工学部講義棟 A

講演セッション 第 1 日目 (3 月 8 日)

	【A 会場】		【B 会場】		【C 会場】
9:45	「回路・実装設計技術」 座長：白石洋一（群馬大学） 8A-01 LSI シールド用板金のシールド特性基礎評価 ○上村武史 (FATEC)	9:45	「材料技術」 座長：上田 充（東京工業大学） 8B-01 潜在性硬化促進機能を有する有機化クレイの作製とナノコンポジットの物性 ○齋藤恵司， 大山俊幸， 高橋昭雄（横浜国立大学）	9:45	「システムインテグレーション実装技術」 座長：高野 希（日立化成工業(株)） 8C-01 依頼講演 3次元集積デバイスの開発課題 ○折井靖光（日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所）
10:00	8A-02 垂直磁化方式 MRAM に向けた三次元シミュレーションによるシールド構造の検討 ○渡邊敬仁 ¹ ， 眞子隆志 ² ， 山道新太郎 ¹ （ルネサス ¹ ， NEC ² ）	10:00	8B-02 エポキシ変性ポリベンゾオキサジンの反応と高性能化 ○賀川美香， 大山俊幸， 高橋昭雄（横浜国大院工）		
10:15	8A-03 ADI 法を適用したブロック LIM に基づく多層電源分配網解析 ○石丸友紀， 浅井秀樹（静岡大）	10:15	8B-03 マレイミド-ベンゾオキサジン反応を利用した耐熱性樹脂の作製 ○高岩玲生 ^{1,2} ， 賀川美香 ^{1,2} ， 大山俊幸 ¹ ， 高橋昭雄 ¹ （横浜国大院工 ¹ ， 神奈川科学技術アカデミー ² ）	10:15	8C-02 擬似 SOC 技術を用いたワンチップモジュールの樹脂硬化収縮に関する考察 ○飯田敦子， 小野塚 豊， 長野利彦， 山田 浩， 板谷和彦（(株)東芝研究開発センター）
10:30	8A-04 反復 LIM による大規模線形回路網の高速過渡解析とその評価 ○關根惟敏， 浅井秀樹（静岡大）	10:30	8B-04 銀合金ワイヤーを使ったボンディング性能と信頼性評価 ○今野大悟 ¹ ， Tsai Cash ² （西華産業株式会社 ¹ ， Wire Technology Co., Ltd. ² ）	10:30	8C-03 フリップチップ実装応力の銅パンプ機械特性依存性 ○中平航太， 多胡弘紀， 遠藤史明， 鈴木 研， 三浦英生（東北大）
10:45	8A-05 CAD 機種に依存しないアートワーク設計支援システムの開発 ○瀧澤隆博， 熊木雄大， 有坂睦生， 芳賀 知（OKI プリンテッドサーキット株式会社）	10:45	休憩	10:45	休憩
11:00	休憩	11:00	「材料技術」 座長：小林一治（(株)フジクラ） 8B-05 依頼講演 新規高熱伝導性エポキシモノマーの開発 ○早川晃鏡 ¹ ， 前田利菜 ¹ ， Choi Heejung ¹ ， 柿本雅明 ¹ ， 漆畑広明 ¹ ， 鵜崎晋也 ² ， 三村研史 ² ， 信時英治 ² （東京工業大学 ¹ ， 三菱電機 ² ）	11:00	「システムインテグレーション実装技術」 座長：野中敏央（東レ(株)） 8C-04 表面活性化接合における不均一性に関する応力解析 ○後藤啓介， 王 英輝， 須賀唯知（東大）
11:15	「回路・実装設計技術」 座長：上田千寿（(株)エーイーティー） 8A-06 依頼講演 3次元実装に関する福岡クラスター事業の取り組み ○友景 肇（福岡大）			11:15	8C-05 狭ピッチ金属マイクロパンプを有するチップの自己組織化実装技術 ○福島誉史， 岩田永司， マリアッパナムルゲサン， 裴 志哲， 李 康旭， 田中 徹， 小柳光正（東北大）
		11:30	8B-06 ネガ型感光性ポリチオフェンの開発 ○齋藤悠太， 遠藤啓太， 大清水 薫， 東原知哉， 上田 充（東工大）	11:30	8C-06 ナノ積層型多層膜を用いた LSI デバイスのホットスポット低減へ向けた検討 ○加藤史樹 ¹ ， 菊地克弥 ¹ ， 青柳昌宏 ¹ ， 岩下徹幸 ² ， 藤原英道 ² （産総研 ¹ ， 古川電工 ² ）
11:45	8A-07 3次元実装のためのクラスターリング配置アルゴリズムの検討 ○Anh TuanDang ¹ ， 白石洋一 ¹ ， 上野和弘 ² （群馬大学大学院 ¹ ， 株式会社アズマ ² ）	11:45	8B-07 シェアテスターによる絶縁樹脂材料の密着力評価 ○飯森弘和 ¹ ， 船津圭亮 ¹ ， 川本佳史 ¹ ， 宮崎大地 ² ， 南橋克哉 ² ， 富川真佐夫 ² （CASMAT ¹ ， 東レ株式会社 ² ）	11:45	8C-07 表面活性化接合を用いた垂直配向 MWNT と金薄膜の接合と転写 ○藤野真久 ¹ ， 須賀唯知 ¹ ， 曾我育夫 ² ， 近藤大雄 ² ， 石月義克 ² ， 岩井大介 ² （東大工 ¹ ， 富士通研究所， 富士通 ² ）
12:00	8A-08 伝送線路シミュレーションにおける実装用パッドの影響 ○長谷川清久， 三輪 等， 大脇 敦， 王 賢正， 丹後智之（イビテック株式会社）	12:00	休憩	12:00	休憩
12:15	8A-09 IBIS モデルの記述がシミュレーション波形に与える影響 ○楠 和彦 ¹ ， 長谷川清久 ² ， 大脇 敦 ² （WADOW コーポレーション ¹ ， イビテック株式会社 ² ）				
12:30	8A-10 3D 電磁界解析を利用した基板設計 ○前田真一 (KEI Systems)				

第 1 日目【3 月 8 日】

ポスターセッション

場所: D 会場

座長: 井関裕二 ((株)東芝)

- 10:00 **8DP-01** 多価フェノール二量体硬化多環芳香族型エポキシ樹脂の研究
○小林宇志^{1,2}, 堀内悠斗¹, 大山俊幸¹, 高橋昭雄¹ (横浜国大院工¹, 財団法人神奈川科学技術アカデミー²)
- 10:05 **8DP-02** *In situ* 重合改質剤による高耐熱シアナート樹脂の強靱化
○磯野 学, 大山俊幸, 高橋昭雄 (横浜国大院工)
- 10:10 **8DP-03** ネガ型反応現象画像形成に基づくアルカリ水溶液現象型感光性スルホン化ポリイミドの開発
○笠原 彩, 高橋昭雄, 大山俊幸 (横浜国大院工)
- 10:15 **8DP-04** フリーシアン浴を用いた電解銀めっきによるワイヤーグリッド偏光フィルムの作製
○小山義則¹, 岡本尚樹¹, 齊藤丈靖¹, 森本 勲², 土屋貴之³, 丸中正雄³, 近藤和夫¹ (大阪府立大学¹, 旭化成株式会社², 新明和工業株式会社³)
- 10:20 **8DP-05** 鉛フリーはんだ鍍先への Fe-MWCNT 複合めっき適応性についての検討
○渡辺 潤^{1,2}, 関守宣久³, 宮崎 誠¹, 初澤健次¹, 上谷孝司³, 荘司郁夫² (長野沖電気株式会社¹, 群馬大学 大学院², 白光株式会社³)
- 10:25 **8DP-06** EBG 構造の阻止帯域広帯域化に関する一考察 (須藤俊夫, 野瀬正秀, ○酒井まゆみ, 吉澤智大 (芝浦工大))
- 10:30 **8DP-07** DDR3 の PDN インピーダンス特性 (金澤誠人¹, ○佐々木勇人¹, 須藤俊夫¹, 冨島敦史², 金子俊之³ (芝浦工大¹, 東芝², TNCSI³))
- 10:35 **8DP-08** LCD ドライバ IC のチップ・パッケージ・ボードモデル
○佐久間光治, 須藤俊夫 (芝浦工大)
- 10:40 **8DP-09** 電源ノイズ評価システムの構築 (奥村尚史, ○大井園佳聡, 鍋島義孝, 須藤俊夫 (芝工大))
- 10:45 休憩
- 座長: 寺崎 健 ((株)日立製作所)
- 11:00 **8DP-10** SiN 及び Al へのメタライゼーションの基礎的検討
○押切純貴¹, 中田龍之介¹, 梅本博史¹, 橋本 晃², 小岩一郎¹ (関東学院大学小岩研究室¹, 関東学院大学工学総合研究所²)
- 11:05 **8DP-11** 異方性無電解 Cu めっきを用いたレジストレス回路パターン形成
○新城沙耶加¹, 馬場邦人^{1,2}, 田代雄彦², 渡辺充広², 本間英夫¹ (関東学院大¹, 関東学院大表面研²)
- 11:10 **8DP-12** Sn-Sb はんだ接合部の機械的信頼性
○藤澤仁之¹, 小坪政貴², 荻谷義治², 渡邊裕彦³, 外園洋昭³, 浅井竜彦³ (芝浦工大大学院¹, 芝浦工大 工学部², 富士電機ホールディングス(株)³)
- 11:15 **8DP-13** β -Sn 単結晶の低サイクル疲労寿命におよぼす結晶方位の影響
○山田彩織¹, 小田切 啓¹, 荻谷義治² (芝浦工大大学院¹, 芝浦工大工学部²)
- 11:20 **8DP-14** 大規模 FEM 解析による高密度 LSI パッケージ用アンダーフィル材の最適物性の検討
○島崎 聡¹, 荻谷義治², 佐藤敏行³, 榎本利章³, 小林 誠³ (芝浦工業大学大学院¹, 芝浦工業大学工学部², ナミックス株式会社³)
- 11:25 **8DP-15** Sn-Ag 系および Sn-Cu 系合金における金属間化合物品出後の β -Sn の形状と過冷度の関係
○鷹松喜子, 江阪久雄, 篠塚 計 (防衛大学校)
- 11:30 **8DP-16** 電解 Au/Pd/Ni めっきのための Pd-P 皮膜の作製
○加藤育洋¹, 浅沼雄貴¹, 村上祥教², 渡邊秀人², 本間英夫¹ (関東学院大¹, 小島化学薬品(株)²)
- 11:35 **8DP-17** スクリーン印刷法によるポリイミド膜の厚膜化の検討
○瀬川繁昌, 五島敏之, 脇 周三 (ピーアイ技研)
- 11:40 **8DP-18** 無電解めっきのニッケルメッキ合金膜の三次元パターニング技術
○張 毅¹, 伊藤寿浩¹, 高木秀樹¹, 前田龍太郎¹, 戸田 顯², 冨澤 保² (産総研¹, メルテックス²)

第1日目【3月8日】

【表彰式】

2010年春季講演大会（前回大会）の講演大会優秀賞および研究奨励賞の表彰

時間：14:45～15:10

場所：工学部講義棟 A 2 階 大講義室

〈注〉ポスターアワードの表彰式は第3日目（3月10日）13:00～13:30 A 会場

【特別講演1】

日時：15:15～16:15

場所：工学部講義棟 A 2 階 大講義室

座長：羽深 等（横浜国立大学）

◆エレクトロニクス実装学会 第2代会長（現 金沢工業大学工学部 教授） 多田 邦雄
「半導体集積回路研究開発の黎明期—半世紀前の日本の貢献—」

【特別講演2】

日時：16:15～17:15

場所：工学部講義棟 A 2 階 大講義室

座長：羽深 等（横浜国立大学）

◆NEC 東芝スペースシステム株式会社 技術本部 エキスパートエンジニア 檜原 弘樹
「“はやぶさ”をミッション完遂に導いた開発プロセス」

【交流会】

日時：17:30～19:00

場所：大学会館 3階 きゃら亭

講演セッション 第2日目(3月9日)(1/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
9:45	「高速伝送実装」 座長：谷 貞宏（シャープ(株)） 9A-01 基板対基板の直接接続構造における信号伝送特性の基礎検討 ○山岸圭太郎 ¹ ，石橋拓真 ² ，澁谷幸司 ¹ ，上馬弘敬 ¹ （三菱電機株式会社情報技術総合研究所 ¹ ，三菱電機エンジニアリング株式会社 鎌倉事業所 ² ）	9:45	「部品内蔵基板技術」 座長：猪川幸司（日本CMK(株)） 9B-01 依頼講演 部品内蔵技術の標準化の最近の活動 ○小岩一郎（関東学院大）	9:45	「材料技術」 座長：高橋昭雄（横浜国立大学） 9C-01 アクリル系コーティング剤への導電性ペーストの印刷性 ○山下宗哲 ¹ ，高田浩平 ² ，森 隆志 ² ，的場哲也 ² ，栢木 實 ² ，宮崎 崇 ¹ ，前田拓也 ¹ ，伊藤 修 ¹ （和歌山県工業技術センター ¹ ，新中村化学工業株式会社 ² ）
10:00	9A-02 高速デジタル回路におけるAC結合回路の最適グラウンドクリアランスサイズの簡易計算式の提案とアイ・パターンの解析 ○奈良茂夫（富士ゼロックス株式会社）			10:00	9C-02 プリントドデバイスのための電極の仕事関数制御 ○吉田 学，末森浩司，植村 聖，星野 聰，高田徳幸，小笹健仁，鎌田俊英（産総研）
10:15	9A-03 スルーレート可変による遠端クロストーク低減法の評価 ○加藤 卓，佐々木伸一（佐賀大）	10:15	9B-02 依頼講演 部品内蔵基板の国際標準活動 ○青木正光（標準化グループ）	10:15	9C-03 液晶ポリマーフィルムを用いためっき法による銅張積層板の高周波特性 ○大賀賢一，藤澤季実子，座間 悟，鳥光 悟，福地稔栄（古河電気工業株式会社）
10:30	9A-04 伝送線路解析における受動部品モデル（Sパラ）活用 ○松澤浩彦，小林基行（図研）			10:30	休憩
10:45	休憩	10:45	休憩		
11:00	「高速伝送実装」 座長：浅井秀樹（静岡大学） 9A-05 依頼講演 新しい孤立電磁波理論に基づくデジタルシステムの性能向上技術 ○遠矢弘和，遠矢紀尚（株式会社アイキャスト）	11:00	「部品内蔵基板技術」 座長：小岩一郎（関東学院大学） 9B-03 依頼講演 部品内蔵プリント配線板の適用事例と今後の課題 ○見山克己（北海道工大）	11:00	「材料技術」 座長：田畑晴夫（大阪大学） 9C-04 依頼講演 パワーデバイスパッケージの実装技術 ○宝蔵寺裕之，石井利昭，守田俊章，保田雄亮（日立製作所）
11:30	9A-06 アナログリピータによる高速デジタル信号のケーブル伝送方式 ○鈴木雄将，明星慶洋，上馬弘敬，斉藤成一（三菱電機）	11:30	9B-04 薄型能動・受動部品内蔵ポリイミド多層配線板 ○上田啓貴，岡本誠裕，佐野宜紀，奥出 聡，鈴木孝直，中尾 知（株式会社フジクラ）	11:30	9C-05 ジアリアルアミンを用いたTSV電気銅めっきの高速化 ○林 太郎 ¹ ，竹内 実 ² ，岡本尚樹 ¹ ，齋藤丈靖 ¹ ，近藤和夫 ¹ ，丸中正雄 ³ ，土屋貴之 ³ ，文屋 勝 ² （大阪府立大学 ¹ ，日東紡績 ² ，新明和工業 ³ ）
11:45	9A-07 一括積層法によるプリント配線板技術を用いた同軸配線構造に関する検討 ○高須慶之 ^{1,2} ，菊地克弥 ² ，仲川 博 ² ，越地耕二 ¹ ，青柳昌宏 ^{1,2} （東京理科大 ¹ ，産総研 ² ）	11:45	9B-05 三次元LSI集積化へ向けたキャパシタ内蔵インターポーザの電源インピーダンス評価 ○菊地克弥 ¹ ，秋山 豊 ² ，島倉 啓 ³ ，竹村浩一 ³ ，五明利雄 ³ ，大久保利一 ³ ，小山鉄也 ³ ，村上朝夫 ³ ，青柳昌宏 ¹ ，大塚 寛治 ² （産総研 ¹ ，明星大 ² ，ASET ³ ）	11:45	休憩
12:00	9A-08 非因果性と因果性のWエレメントモデルによるタイムドメイン解析の違い ○野田敦人（シグナル工房）	12:00	休憩		
12:15	休憩				
13:00	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：和田修己（京都大学） 9A-09 依頼講演 パワーエレクトロニクスシステムにおけるEMC解析技術 ○三島 彰（日立製作所情報制御システム社ドライブシステムセンター）			13:00	「検査技術」 座長：山崎 浩（日置電機(株)） 9C-06 依頼講演 バウンダリスキャンテスト機構を流用するオープン不良の電気的テストとその可能性 ○橋爪正樹，小西朝陽，四柳浩之（徳島大学）

講演セッション 第2日目 (3月9日) (2/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
	9A-09 つづき	13:15	「信頼性解析技術」 座長：熊沢鉄雄（秋田県立大学） 9B-06 均質化法を用いたBGAパッケージの反り挙動予測 ○鈴木智久 ¹ ，寺崎 健 ¹ ，田中俊明 ² ，竹越正明 ² （株式会社日立製作所機械研究所 ¹ ，日立化成工業株式会社 ² ）		9C-06 つづき
13:30	9A-10 スイッチング電源のノイズ解析とボードデザインの考察 ○桐畑美耶 ¹ ，高橋成正 ² ，須藤俊夫 ³ ，奥村尚史 ³ ，泊 和岳 ³ ，柳田 進 ¹ （ライズコーポレーション ¹ ，日本IBM ² ，芝浦工業大学 ³ ）	13:30	9B-07 デジタル画像相関法によるひずみ計測を用いた三次元積層チップの非線形有限要素法解析精度の改善 ○岡 大智，河原真哉，池田 徹，宮崎則幸（京都大）	13:30	9C-07 電磁界シミュレータによるTSVの半断線で生じる故障動作解析 ○近藤将平，四柳浩之，橋爪正樹（徳島大学）
13:45	9A-11 信号品位改善を目的としたPLL回路のノイズ対策 ○鍋倉秀一，斎藤耕太，五十棲勇介，三原恭次（(株)村田製作所）	13:45	9B-08 材料物性のばらつきを考慮した車載用電子部品の信頼性評価 ○西村悠司，于 強（横浜国立大学）	13:45	9C-08 TDR法によるプリント基板の検査技術 ○中野一機 ¹ ，金谷雅夫 ¹ ，石井宏之 ¹ ，島寄 睦 ² （三菱電機株式会社生産技術センター ¹ ，三菱電機株式会社設計システム技術センター ² ）
14:00	9A-12 プリント配線板電源層からの放射雑音低減方法の検討～電源層外形と低減効果～ ○高倉一旨，佐々木伸一（佐賀大）	14:00	9B-09 SiCパワー半導体素子の高温動作における熱応力の評価 ○チェンチョル，佐藤 弘，仲川博，郎 豊群，劉 小軍，山口 浩（産業技術総合研究所）	14:00	9C-09 静電容量を用いた微細プリント配線欠陥検査システムに関する研究 ○野口祐智，角田興俊，富田英雄，斎藤之男（東京電機大学）
14:15	休憩	14:15	休憩	14:15	休憩
14:30	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：高橋丈博（拓殖大学） 9A-13 空間電力伝送用アンテナの電力伝送効率の解析 ○菊地秀雄 ¹ ，上田千寿 ² （トッパンNECサーキットソリューションズ ¹ ，エーイーティー ² ）	14:30	「信頼性解析技術」 座長：田辺一彦（NECインフロンティア(株)） 9B-10 放射光X線CTによるチップ抵抗はんだ接合部における熱疲労き裂進展過程の実験的評価 ○釣谷浩之 ¹ ，佐山利彦 ¹ ，岡本佳之 ² ，高柳 毅 ² ，上杉健太郎 ³ ，森孝男 ⁴ （富山県工業技術センター ¹ ，コーセル株式会社 ² ，高輝度光科学研究センター ³ ，富山県立大学 ⁴ ）	14:30	「電子部品・実装技術」 座長：土門孝彰（TDK(株)） 9C-10 依頼講演 有機薄膜太陽電池の高性能化 ○田島右副（理化学研究所）
14:45	9A-14 磁気共鳴方式を用いたワイヤレスエネルギー伝送の検討 ○鈴木彬史，山本隆彦，越地耕二（東京理科大学）	14:45	9B-11 はんだ/炭素鋼界面反応層の成長速度と炭素濃度の関係 ○川本崇彰 ¹ ，山内 啓 ² ，川久保 聡 ³ ，入澤 淳 ³ ，黒川一哉 ² ，田中順一 ¹ （北大院工 ¹ ，北大エネマテ研 ² ，株式会社弘輝 ³ ）		
15:00	9A-15 人体通信技術のユーザーインタフェースへの適用の検討 ○鍵本圭吾，王 建青（名工大）	15:00	9B-12 電子機器プリント基板の信頼性設計における不規則動荷重の統計的算定法の提案 ○久國陽介，大森隆広，廣畑賢治，向井 稔（(株)東芝）	15:00	9C-11 電子部品の耐食性に及ぼす下地Ni-Pめっきの効果 ○田所義浩 ^{1,2} ，古澤 毅 ² ，佐藤正秀 ² ，鈴木 昇 ² （第一電子工業株式会社 ¹ ，宇都宮大 ² ）
15:15	9A-16 IR-UWB人体通信トランシーバの製作と評価 ○鹿田景之，王 建青（名工大）	15:15	9B-13 実使用状況を考慮した電子デバイスの信頼性評価 ○劉 士林，于 強，小林将広（横国大）	15:15	9C-12 Cuワイヤボンディング用無電解Ni/Pd/Auめっき技術 ○江尻芳則 ¹ ，櫻井健久 ¹ ，黒川 博 ¹ ，鈴木邦司 ¹ ，坪松良明 ¹ ，畠山修一 ¹ ，有家茂晴 ¹ ，荒山貴慎 ¹ ，廣山幸久 ¹ ，長谷川 清 ¹ （日立化成工業株式会社 ¹ ，日立化成テクノサービス株式会社 ² ）
15:30	9A-17 人体通信に用いる電極の構造および測定用ファントムに関する検討 ○村松大陸 ¹ ，山本隆彦 ^{1,2} ，越地福朗 ² ，越地耕二 ^{1,2} （東京理科大学 ¹ ，東京理科大学総合研究機構 ² ）	15:30	9B-14 パワーデバイス解析モデルを用いた疲労寿命評価 ○篠原主勲 ¹ ，于 強 ² （財団法人神奈川科学技術アカデミー ¹ ，横浜国立大学 ² ）	15:30	9C-13 無電解めっきによるW-CSPに用いる異なった素材へのメタライゼーションの基礎的検討 ○梅本博史 ¹ ，押切絢貴 ¹ ，中田龍之介 ¹ ，橋本 晃 ² ，小岩一郎 ¹ （関東学院大学小岩研究室 ¹ ，関東学院大学工学総合研究所 ² ）

講演セッション 第2日目 (3月9日) (3/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
15:45	休憩	15:45	休憩	15:45	休憩
16:00	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：須藤俊夫（芝浦工業大学） 9A-18 コンデンサ内蔵インターポーザにおける GHz 帯のノイズ耐性評価 ○井ノ上大輔¹，齊藤義行¹，佐々木智江¹，高橋英治¹，末永 寛¹，菅谷康博²（パナソニック(株)¹，パナソニックエレクトロニクスデバイス(株)²）	16:00	「信頼性解析技術」 座長：岡本健次（富士電機ホールディングス(株)） 9B-15 Sn-Ag-Cu はんだ接合部の熱疲労寿命に及ぼす温度サイクル条件の影響 ○門田朋子，向井 稔，廣畑賢治（東芝）	16:00	「電子部品・実装技術」 座長：三宅敏広（(株)デンソー） 9C-14 ノンシアン無電解めっき法による微細 Au バンプを用いたチップ間接続特性の評価 ○安 陽太郎^{1,2}，菊地克弥²，加藤史樹²，根本俊介²，仲川 博²，越地耕二¹，青柳昌宏^{1,2}（東京理科大¹，産総研²）
16:15	9A-19 金属筐体とプリント回路基板のグランド接続位置に対する静電気放電ノイズの FDTD 解析 ○藤田和広，並木武文（富士通）	16:15	9B-16 車載用 DBA 基板パワーデバイスのはんだ接合部の熱疲労寿命評価に関する研究 ○趙 世強，于 強，赤枝弘樹（横浜国立大学大学院）	16:15	9C-15 Cu バンプを用いたチップ間常温かしめ接続技術の開発 ○川下道宏¹，吉村保廣¹，友常仁之¹，田中直敬¹，植松俊英²，宮崎忠一²，渡辺直也³，浅野種正³（(株)日立製作所 機械研究所¹，ルネサスエレクトロニクス(株)²，九州大学³）
16:30	9A-20 プリント基板上の印加ノイズ伝搬経路測定評価方法の一検討 ○安藤雄二，内田 雄，佐々木雄一，宮崎千春，岡 尚人，三須幸一郎（三菱電機）	16:30	9B-17 ミクロ構造を考慮した鉛フリーはんだ接合部の疲労強度特性に関する研究 ○阿久津敬弘，于 強（横浜国大）	16:30	9C-16 銅ナノ粒子ペーストの真空焼結性に及ぼす予熱条件の影響 ○山川智弘¹，下田将義¹，塩川国夫²，上田雅行³，阿部真太郎³，竹本 正¹（大阪大¹，富士電機²，ハリマ化成³）
16:45	9A-21 LAN ケーブルの 3Gbps 超級差動信号伝送への応用検討 ○野崎孝英，中西秀行，田中顕裕（アイカ工業）	16:45	9B-18 Sn 基合金の疲労延性指数におよぼす繰り返しひずみ硬化指数の影響 ○神田喜彦¹，大戸悠司¹，椎木祐介²，苅谷義治²（芝浦工業大学大学院¹，芝浦工業大学²）	16:45	9C-17 ナノ粒子堆積技術による Au 錐形バンプの作製 ○居村史人¹，劉 小軍¹，根本俊介¹，加藤史樹¹，菊地克弥¹，鈴木基史¹，仲川 博¹，青柳昌宏¹，五味善宏²，斉藤伊織²，長谷川 弘²（産総研¹，株式会社みくに工業²）
17:00	9A-22 伝送線路に流れるコモンモード電流分布の推定 ○糸原和也，越地耕二（東京理科大）			17:00	9C-18 LED デバイスへの応用を目的とした Ga-P への金属薄膜形成 ○冨田達也，原 貴俊，渡邊 裕，那須龍宗，配島雄樹，小岩一郎，橋本 晃，高梨 博（関東学院大学）
17:15	9A-23 平衡ケーブルのシールド処理に対するノイズ耐性 ○渡邊陽介，佐々木雄一，宮崎千春，岡 尚人，三須幸一郎（三菱電機株式会社）			17:15	9C-19 集束プロトンビーム描画によるポリイミドの微細加工 ○武野 泰¹，濱田拓也²，西川宏之^{2,3}，林 秀臣³（芝浦工業大学大学院¹，芝浦工業大学²，芝浦工業大学先端工学研究機構³）

第2日目【3月9日】

ものづくりセッション

場所: D 会場

- 座長: 星 幸紀 (大昌電子(株))
- 9:45 **9D-01** 放熱材料評価技術
○高根悦子¹, 山口欣秀¹, 天野泰雄¹, 稲田禎一², 山本 礼², 永井 晃², 加藤薫子¹ (株式会社日立製作所¹, 株式会社日立化成工業²)
- 10:05 **9D-02** 実装工程間の外観検査データ連携システムを用いた品質管理手法
○谷上昌伸 (オムロン株式会社)
- 10:25 **9D-03** 高密度実装基板における S パラメータの応用 (デバッグの実例)
○辻 嘉樹 (レクロイ・ジャパン株式会社)
- 10:45 休憩 (15 分)
- 座長: 中尾 知 ((株)フジクラ)
- 11:00 **9D-04** ロックインサーモグラフィ手法による非破壊不良位置特定
○一宮尚至¹, 戸田 徹¹, 長友俊信¹, Schussler Randall², Schlangen Rudolf² (DCG システムズ株式会社¹, DCG システムズインク²)
- 11:20 **9D-05** 部品内蔵基板の検査システム
○山崎 浩 (日置電機株式会社)
- 11:40 **9D-06** フィルドビアめっき基板検査装置ディンプルスキャン DS-X
○堀内昭男, 篠崎裕規雄 (荏原ユーージャイト株式会社)
- 12:00 休憩 (60 分)
- 座長: 猪川幸司 (日本 CMK(株))
- 13:00 **9D-07** ナノ粒子生成・成膜装置「NP150H」
○五味善宏, 斉藤伊織, 長谷川 弘 (株式会社みくに工業)
- 13:20 **9D-08** ダイアタッチに使われるペーストやフィルムに発生するボイドを無くす加圧式ボイドフリーオープンの性能と効果の実証
○今野大悟¹, 張 景南² (西華産業株式会社¹, 印能科技有限公司²)
- 13:40 **9D-09** ★モバイル機器やモジュール部品等の高密度実装基板を秒速で個片化し, 且つ低コストを実現した分割システムの開発
○新井 功 (シイエムケイメカニクス株式会社)
- 14:00 **9D-10** 3D TSV 半導体を超低コストで実現するナプラの Via 埋め込み技術
○関根重信 (ナプラ)
- 14:20 休憩 (10 分)
- 座長: 上原利久 ((株)トッパン NEC サーキットソリューションズ)
- 14:30 **9D-11** プラズマ処理によるナノ粒子インクの低温短時間焼結技術
○藤立隆史 (電子情報通信学会, 日本電磁波エネルギー応用学会)
- 14:50 **9D-12** プリンテッドエレクトロニクス用新規印刷材料
○神代 恭, 中子偉夫, 稲田麻希, 黒田杏子, 納堂高明, 山本和徳 (日立化成工業(株))
- 15:10 **9D-13** スクリーン印刷用ポリイミドインク Q-IP-X0897
○瀬川繁昌, 五島敏之, 脇 周三 (ピーアイ技研)
- 15:30 **9D-14** 幅広い電流密度に対応したビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤トップルチナ HV
○北原悠平 (奥野製薬工業株式会社)
- 15:50 休憩 (10 分)
- 座長: 和嶋元世 (荏原ユーージャイト(株))
- 16:00 **9D-15** めっき液管理におけるポーラログラフィの応用
○渡口 繁¹, 塚原義人¹, 田嶋和貴¹, 吉田康平², 市場計輔² (メルテックス株式会社¹, メトロームジャパン株式会社²)
- 16:20 **9D-16** 微細配線用無電解ニッケル/パラジウム/金めっきプロセス
○高橋秀臣, 後藤 文, 石川久美子, 谷本樹一 (荏原ユーージャイト株式会社)
- 16:40 **9D-17** 分子界面制御による異種材料の接合
○久保田陽一, 城戸靖彦 (ゼタコア社)
- 17:00 **9D-18** スーパージャフィット (SJ) 法による微小はんだバンプ形成
○堺 丈和, 荘司孝志 (昭和電工株式会社)
- 17:20 **9D-19** 高多層ビルドアップ基板の開発
○桑原直樹 (TNCSi)

第2日目【3月9日】

学生・初学者向けチュートリアルセッション

電子機器のものづくりを知ろう。／—実装技術を分かり易く説明—

共催：YUVEC, YJC（よこはま高度実装コンソーシアム）

日時：3月9日(水) 10:00～15:50

場所：E会場

座長：宮代文夫(YJC)

①10:00～10:30 (30分)

電子機器における電子回路実装の重要性

羽深 等（横浜国立大学教授）

②10:30～11:10 (40分)

プリント配線板の役目とその作り方

高木 清(YJC)

休憩（10分間）

③11:20～12:00 (40分)

電子部品とその実装

本多 進(YJC)

休憩（1時間）

座長：高木 清(YJC)

④13:00～13:40 (40分)

身近なデジタル機器

井上博文(NEC)

⑤13:40～14:20 (40分)

電子機器の実装に関わる設計と製造

八甫谷明彦（東芝）

休憩（10分間）

座長：本多 進(YJC)

⑥14:30～15:10 (40分)

電気自動車のインパクト

宮代文夫(YJC)

⑦15:10～15:50 (40分)

宇宙に広がる実装技術

村富洋一（横浜国立大学教授）

*セッション終了後16:00から、希望者によりキャンパスツアー（横浜国立大学内の設備などの見学会）を行います。

講演セッション 第3日目 (3月10日) (1/3) E会場は次々ページに記載

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
9:45	「パワーエレクトロニクス実装」 座長：高野 希（日立化成工業(株)） 10A-01 依頼講演 次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト 筒木壮太，○河村篤男（横浜国立大学）	9:45	「配線板製造技術」 座長：吉原佐知雄（宇都宮大学） 10B-01 高信頼性リジッドフレキシブル基板の開発 ○雨宮広泰，加藤勝宗，石黒欽也，辰己聖和（(株)トッパン NEC サーキットソリューションズ）	9:45	「光回路実装技術」 座長：杉原興浩（東北大学） 10C-01 依頼講演 JIEP 光インターコネクションロードマップ WG 報告 ○柳町成行（日本電気株式会社）
		10:00	10B-02 Ag ペースト焼結助剤成分が無電解 Ni/Au めっきプロセスに及ぼす影響 ○津野勇輝，長尾由起，田邊靖博，村橋浩一郎，森本 徹（奥野製薬工業株式会社）		
10:15	10A-02 エポキシマトリックス中に BN 粒子を高配向した超高熱伝導複合材料の研究 ○宮田建治 ¹ ，山縣利貴 ¹ ，阿尻雅文 ² （電気化学工業株式会社 ¹ ，東北大学 ² ）	10:15	10B-03 スクリーンメッシュによる解像度の比較 ○瀬川繁昌，五島敏之，脇 周三（ピーアイ技研）	10:15	10C-02 波長アドレス方式による再構成可能な多層光配線ボード間光インターコネクションの検討 ○仲間健一，三上 修（東海大）
10:30	10A-03 AlN 多層基板に於ける金属拡散現象の追跡 ○永野幸雄 ¹ ，中島健作 ¹ ，太田正壽 ² ，上松和義 ² （イビデン株式会社 ¹ ，新潟大学工学部 ² ）	10:30	10B-04 フッ化水素酸処理によるポリイミド樹脂/めっき皮膜間の密着性向上 ○高德 誠，中丸弥一郎（荏原ユーザライト）	10:30	10C-03 光硬化樹脂の光プラグ・ソケットを用いた光接続法の提案 ○松澤雄介，脇田智大，常盤論生，仲間健一，三上 修（東海大）
10:45	休憩	10:45	休憩	10:45	休憩
11:00	「パワーエレクトロニクス実装」 座長：廣畑賢治（(株)東芝） 10A-04 電気-熱-構造連成解析によるパワーデバイスの故障要因判別と信頼性評価 ○小林将広（横国大）	11:00	「配線板製造技術」 座長：雀部俊樹（(株)メイコー） 10B-05 無電解ニッケルめっき液中成分の電気化学測定法の開発 ○塚原義人 ¹ ，渡口 繁 ¹ ，田嶋和貴 ¹ ，吉岡孝恭 ² ，柳本 博 ² （メルテックス株式会社 ¹ ，トヨタ自動車株式会社 ² ）	11:00	「光回路実装技術」 座長：三上 修（東海大学） 10C-04 ダイシングを用いた多チャンネルポリイミド光導波路フィルムの低損失化の検討 ○木下智嗣，伊藤浩希，石田宏司（千歳科学技術大学）
11:15	10A-05 パワエレスシステムのシステムシミュレーション ○重松浩一，加藤 操（サイバネットシステム株式会社）	11:15	10B-06 硫酸銅めっきにおけるピアフィリングの添加剤挙動の検討 ○和久田陽平 ¹ ，杉本将治 ² ，渡辺充広 ² ，山下嗣人 ^{3,4} ，本間英夫 ^{3,4} （関東学院大学 ¹ ，関東学院大学表面工学研究所 ² ，関東学院大学 工学部 ³ ，関東学院大学 材料・表面工学研究センター ⁴ ）	11:15	10C-05 ポリマー並列光導波路におけるクロストーク要因の解析と導波路構造設計 ○四反田圭士郎，徐 祥瀚，石樽崇明（慶大）
11:30	10A-06 耐高温パワーデバイスにおける Ni メッキの疲労特性の評価方法に関する研究 ○石川隆之 ¹ ，忍足俊一 ² ，杉原弘恵 ¹ ，于 強 ¹ （横国大 ¹ ，日産 ² ）	11:30	10B-07 金めっき浴中における銅不純物の電気化学的手法を用いた管理技術の検討 ○高橋俊也 ¹ ，吉原佐知雄 ¹ ，野澤純一 ² ，野尻尚克 ² （宇都宮大院工 ¹ ，(株)大昌電子 ² ）	11:30	10C-06 高屈折率ハイブリッド材料開発と光回路への応用 ○杉原興浩，工藤進平，金子 周，久保祥一，中川 勝（東北大）
11:45	10A-07 Bi-Ag 系高温鉛フリーはんだの基礎実装特性 ○下田将義 ¹ ，山川智弘 ¹ ，塩川国夫 ² ，西川 宏 ¹ ，竹本 正 ¹ （大阪大 ¹ ，富士電機 ² ）	11:45	10B-08 銅箔製造用電析浴中の添加剤の作用機構に及ぼす浴攪拌と電流密度の影響 ○秋葉拓也 ¹ ，吉原佐知雄 ² ，松田光由 ³ （宇都宮大工 ¹ ，宇都宮大院工 ² ，三井金属総研 ³ ）	11:45	10C-07 プロトンビームに対するシロキサンの反応性を利用した微細光学素子の直接描画加工 ○斉藤圭祐 ¹ ，土屋龍太郎 ¹ ，西川宏之 ¹ ，林 秀臣 ² （芝浦工業大学 ¹ ，芝浦工業大学先端工学研究機構 ² ）
12:00	休憩	12:00	休憩	12:00	休憩
13:00	ポスターアワード表彰式				
13:30	「信頼性解析技術」 座長：三浦英生（東北大学） 10A-08 依頼講演 フレキシブル色素増感太陽電池の開発と性能・耐久性解析 ○宮坂 力，池上和志（桐蔭横浜大学）	13:30	「環境調和型実装技術」 座長：林 秀臣（エコデザイン推進機構） 10B-09 銀ナノワイヤー透明導電膜の室温作製プロセス ○徳野剛大 ¹ ，能木雅也 ² ，菅沼克昭 ² （大阪大学工学研究科 ¹ ，大阪大学産業科学研究所 ² ）	13:30	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：重藤暁津（物質・材料研究機構） 10C-08 依頼講演 はんだ－高分子ハイブリッド材によるマイクロ接続のための自己形成プロセス ○安田清和（名古屋大学）

講演セッション 第3日目 (3月10日) (2/3) E会場は次ページに記載

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
	10A-08 つづき	13:45	10B-10 低環境負荷プロセスに向けた新規塗布型シリコン材料の開発 ○原 憲司, 岩島智幸, 尾見仁一, 末吉 孝, 斎藤誠一 (ADEKA)		10C-08 つづき
14:00	10A-09 Low-k TEG ウエハを用いた半導体パッケージのプロセスの評価 ○戸高徹哉 ¹ , 友景 肇 ¹ , 堀内 整 ² , 林 繁宏 ² , 崔 雲 ¹ , 升本 睦 ¹ (福岡大学 ¹ , 福岡県産業・科学技術振興財団 ²)	14:00	10B-11 アルミ電解コンデンサ向け電解液吸収材の吸収効果 ○森 浩一, 八木 稔, 野末 満, 佐藤重明 (栗田工業)	14:00	10C-09 無洗浄はんだペーストの印刷と水素ラジカルリフローを用いたマイクロデバイスの封止技術の開発 ○押川紘樹 ¹ , 山本真一 ¹ , 日暮栄治 ¹ , 須賀唯知 ¹ , 岡田咲枝 ² (東京大学 ¹ , 千住金属 ²)
14:15	10A-10 硬化過程を考慮した封止樹脂の熱変形と機械特性に関する研究 ○佐藤裕之, 于 強, 曾根竜介 (横浜国立大学大学院)	14:15	10B-12 データセンタにおける冷却電力削減管理 ○松永有仁, 吉川 実 (日本電気)	14:15	10C-10 実装応力に起因した光実装用VCSEL 素子発光特性の変動 ○大橋悠輔, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)
14:30	10A-11 電子デバイス用封止樹脂の硬化プロセス評価と構造解析 ○曾根竜介, 于 強, 佐藤裕之 (横浜国立大学大学院)			14:30	10C-11 水による表面活性化を利用したガラスの低温接合 ○梅田 隼, 王 晨曦, 須賀唯友 (東大)
14:45	休憩			14:45	休憩
15:00	「信頼性解析技術」 座長: 津久井 勤 (リサーチラボ・ツクイ) 10A-12 めっき銅バンプ・配線接続信頼性に及ぼす微細組織の影響 ○村田直一, 斎藤直樹, 玉川欣治, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)			15:00	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長: 藤井知徳 (太陽誘電(株)) 10C-12 薄膜キャパシタ構造体の付着特性とナノトランスファー法への応用 ○富岡史明 ¹ , 一本正聡 ¹ , 須賀唯知 ¹ , 伊藤寿浩 ² , 飯村慶太 ¹ , 細野智史 ¹ (東大 ¹ , 産総研 ²)
15:15	10A-13 めっき銅薄膜配線のストレスマイグレーション支配因子の解明 ○斎藤直樹, 村田直一, 玉川欣治, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)			15:15	10C-13 多層配線可能な神経再生型電極の作製 ○吉田充宏 ¹ , 浮田芳昭 ² , 廣瀬義人 ¹ , 満洲邦彦 ³ , 内海裕一 ¹ (兵庫県立大学 ¹ , 北陸先端科学技術大学院大学 ² , 東京大学 ³)
15:30	10A-14 温度サイクル試験における錫ウィスカの発生位置予測 ○寺崎 健 ¹ , 加藤隆彦 ² , 大倉康孝 ¹ , 岩崎富生 ¹ , 中村真人 ³ , 石井秀基 ⁴ (日立製作所機械研究所 ¹ , 日立製作所材料研究所 ² , 日立製作所生産技術研究所 ³ , ルネサスエレクトロニクス ⁴)			15:30	10C-14 自己組織化単分子膜によるMEMS スイッチのスティクション防止に関する研究 ○山下崇博 ^{1,2} , 伊藤寿浩 ^{2,3} , 須賀唯知 ^{1,2} (東京大 ¹ , CREST ² , 産総研 ³)
15:45	10A-15 めっきの疲労特性を考慮した高耐熱実装構造の接合部における熱疲労寿命予測手法に関する研究 ○杉原弘恵 ¹ , 忍足俊一 ² , 石川隆之 ¹ , 于 強 ¹ (横国大 ¹ , 日産 ²)			15:45	10C-15 異方性エッチングによるSiノズルを用いたSi微粒子のミスト吐出 ○横山古典 ¹ , 村上隆昭 ¹ , 徳永隆志 ¹ , 伊藤寿浩 ^{1,2} (BEANS研究所 ¹ , 産業技術総合研究所 ²)
				16:00	10C-16 製織技術を用いたメーター級大面積タッチセンサの研究 ○高松誠一 ¹ , 小林 健 ² , 柴山学久 ¹ , 三宅晃司 ² , 伊藤寿浩 ² (BEANS研究所 ¹ , 産総研 ²)
				16:15	10C-17 カーボンナノチューブ埋め込み樹脂によるひずみ測定技術 ○鈴木悠介, 大橋悠輔, 大西正人, 鈴木 研, 三浦英生 (東北大)

講演セッション
第3日目（3月10日）(3/3)

	【E会場】
9:30	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：原田高志（日本電気(株)） 10E-01 誘電体積層基板の複素誘電率の面内異方性の周波数依存性測定 ○和田山修平 ¹ ，小林禰夫 ² ，馬 哲旺 ¹ （埼玉大 ¹ ，サムテック(有) ² ）
9:45	10E-02 平衡形円板共振器法を用いた6～60 GHz にわたる誘電体基板の複素誘電率測定 ○金子彰吾 ¹ ，小林禰夫 ² ，馬 哲旺 ¹ （埼玉大 ¹ ，サムテック(有) ² ）
10:00	10E-03 等方性導電ペーストの配線特性 ○橋本 薫 ¹ ，秋山 豊 ¹ ，河野一雄 ¹ ，大塚寛治 ¹ ，菅沼克昭 ² ，竹内 誠 ³ （明星大 ¹ ，阪大 ² ，ユニサイエンスタケウチ ³ ）
10:15	10E-04 1.6～2.5 GHz における銅張誘電体基板の界面導電率の測定 ○常光理志 ¹ ，小林禰夫 ^{1,2} ，馬 哲旺 ¹ （埼玉大 ¹ ，サムテック(有) ² ）
10:30	10E-05 ミリ波透過性を有する無電解ニッケルめっき皮膜の形成 ○馬場邦人 ¹ ，渡辺充広 ² ，北村佳子 ³ ，高橋順子 ³ ，太田哲司 ³ ，本間英夫 ^{1,2} （関東学院大 ¹ ，(株)関東学院大表面研 ² ，(株)きもと ³ ）
10:45	休憩
11:00	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：久保寺忠（(株)システムデザイン研究所） 10E-06 損失性材料を用いた非侵襲性プローブの検討 ○古賀洋平，山ヶ城尚志（富士通研）
11:15	10E-07 DDR3 における EMI の改善手法の検討 ○内藤政則，金子俊之，海谷清彦（株式会社トッパン NEC サークिटソリューションズ）
11:30	10E-08 プリント配線板における不完全グラウンドによる電流経路への影響 ○酒井辰也，作左部剛視，高橋丈博，澁谷 昇（拓殖大）
11:45	10E-09 抵抗付きキャパシタによる平面基板のコモンモード抑制効果の測定 ○高橋丈博，齋藤 純，作左部剛視，澁谷 昇（拓殖大学）
12:00	10E-10 SiP におけるパワーインテグリティ解析と搭載キャパシタの考察 ○高橋成正（日本アイ・ビー・エム）
12:15	10E-11 パッケージとプリント回路板間の寄生容量に着目した LSI 電源系のコモンモードノイズ低減 ○李 愛花，松嶋 徹，和田修己（京大）
12:30	休憩

第3日目（3月10日）

ものづくりセッション

場所：D会場		座長：本多 進 (YJC)
9:45	10D-01	PCB ソリッドモデリング技術による高精度3次元解析 ○水科秀樹，上谷 純，芳賀 知，田村大輔（沖プリンテッドサーキット株式会社）
10:05	10D-02	部品内蔵基板に最適・最新の設計/検証システムの紹介 ○齋藤昭彦（(株)図研）
10:25	10D-03	部品内蔵用薄膜キャパシタの作製 ○服部篤典，張 維，尾関靖幸，牧野樹強，小川裕誉（株式会社 野田スクリーン）
10:45		休憩（15分） 座長：井上博文 (NEC(株))
11:00	10D-04	ナノ銀透明導電膜の開発 ○中田健一 ¹ ，山根一真 ¹ ，車田光謙 ¹ ，本田晋吾 ¹ ，田万里耕作 ¹ ，ガーバーアーカディー ² ，グランストロムエリック ² （戸田工業株式会社 ¹ ，シーマナノテック社 ² ）
11:20	10D-05	LED，パワーデバイス用高熱伝導材料 ○石原秀樹（日立化成工業株式会社）
11:40	10D-06	次世代パッケージ用ソルダーレジスト ○蔵渕和彦，名越俊昌，田中恵生（日立化成工業(株)）
12:00		休憩（90分） 座長：高木 清 (YJC)
13:30	10D-07	プリンテッドエレクトロニクス向けチッソ樹脂インク材料の応用展開 ○江口 薫（チッソ石油化学株式会社）
13:50	10D-08	優れた熱伝導性，導電性を持つ焼結型銅ペーストの紹介 ○柿澤賢治（株式会社イトー）
14:10	10D-09	低温焼結高耐熱性銀ナノペーストを用いた接合 ○栗田 哲，遠藤圭一，長原愛子，齋藤 悠，久枝 穰 (DOWA)
14:30	10D-10	パワーエレクトロニクス回路基板の「信頼性向上」と「大幅コストダウン」を可能にする WIRELAID PCB 技術 ○池田博昌（第一実業株式会社）
14:50		休憩（10分） 座長：星 幸紀（大昌電子(株)）
15:00	10D-11	LED 対応高熱伝導性基板材料 'EcooL' ○清水広海（パナソニック電工四日市株式会社）
15:20	10D-12	高放熱用 LED 基板の対応 ○生方朋章（日本シイエムケイ株式会社）
15:40	10D-13	高熱伝導絶縁材料「窒化アルミニウム」の新展開 ○今井徹郎（株式会社トクヤマ）
16:00	10D-14	3次元実装用・高気密・貫通ビア付ガラスウェハ 'SCHOTT HermeS(R)' ○小根澤 裕（NEC SCHOTT コンポーネンツ株式会社）